

东吴证券股份有限公司

关于

苏州冠礼科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）

东吴证券股份有限公司

关于苏州冠礼科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之上市保荐书

深圳证券交易所：

苏州冠礼科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“冠礼科技”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“东吴证券”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与发行人为本次发行制作的招股说明书（申报稿）相同。

目 录

目 录.....2

一、发行人基本情况.....3

二、本次发行情况.....15

三、保荐人项目成员情况.....15

四、保荐人与发行人之间的关联关系.....16

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项.....16

六、发行人履行的决策程序.....17

七、关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明及核查情况.....18

八、保荐人对发行人是否符合上市条件的说明.....23

九、对发行人持续督导期间的工作安排.....27

十、保荐人对本次发行上市的推荐结论.....28

一、发行人基本情况

（一）基本情况

中文名称	苏州冠礼科技股份有限公司
注册资本	21,000.00万元
法定代表人	梁进利
有限责任公司成立日期	2016年5月31日
整体变更为股份公司日期	2025年10月22日
住所	苏州高新区浒墅关开发区石林路189号
邮政编码	215151
联系电话	0512-88169099
联系传真	0512-88169099
互联网网址	www.winmaxtech.com
电子信箱	invest@winmaxtech.com

（二）主营业务

公司专注高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售，服务于集成电路、显示面板及电子化学品等泛半导体产业，围绕产业链液态化学品全流程管理需求，提供从系统设计、生产制造、现场安装调试、验收交付到后期运维管理的一站式整体解决方案。公司高纯工艺介质系统支持各类液态化学品的纯化、分装、混配、储存、输送及回收再生，通过调节关键工艺参数对微污染物进行精密控制，保障液态化学品在生产过程中的洁净度、稳定性与安全性，实现持续可靠的供应；公司高阶湿制程工艺设备可应用于泛半导体制造中清洗、显影、刻蚀及去胶等关键环节，是晶圆制造过程中不可或缺的重要装备，其洁净度控制能力与工艺稳定性直接影响产品良率与制程一致性。

作为国内高纯工艺介质系统领域的先行者，公司潜心耕耘二十余载，依托长期积累的工艺理解与系统交付经验，构建起覆盖自动化化学品与研磨液供应系统、电子级化学品纯化及分装系统、废化学品再生系统以及高阶湿制程工艺设备的产品体系，形成支撑先进制造并推动资源循环利用的业务布局。公司主

要产品在各领域的应用示意图如下：



公司始终秉承自主创新、技术深耕的研发理念，历经持续攻关与实践，取得了丰硕的积累。公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省高新区瞪羚企业，并荣获国家优质工程金奖、江苏省高阶湿制程清洗设备工程技术研究中心、“三首两新”认定技术产品企业等多项国家级及省级认证荣誉，亦是国家标准《电子工厂化学品系统工程技术规范》（GB 50781-2012）的主要参编单位。截至报告期末，公司已获得发明专利 64 项，实用新型专利 112 项、外观设计专利 18 项，并拥有计算机软件著作权 51 项，为业务拓展奠定坚实的技术基础。

公司以多学科交叉创新为驱动，以自主知识产权体系为依托，形成具备迭代能力的核心竞争优势。凭借扎实的技术积累、可靠的产品性能及完善的服务体系，公司赢得了众多优质客户的认可与信赖，已与中芯国际、华虹半导体、合肥晶合、长江存储、长鑫存储等国内行业头部企业建立起稳固的合作关系；

报告期内，亦收获了深圳市新凯来技术有限公司等行业新兴企业的青睐。同时，公司积极推动全球化布局，通过新加坡、马来西亚海外子公司搭建国际运营服务网络，成功开拓增长新空间，与住友化学等国际知名客户达成合作。未来，公司将继续聚焦技术创新与产品升级，以高品质产品供给与专业化服务保障为支撑精准匹配客户需求，把握产业发展机遇，稳步拓展市场，巩固业务基础并提升核心竞争力。

（三）核心技术

1、核心技术、技术来源及所处阶段

平台名称	序号	核心技术名称	核心技术特点及先进性表征	技术来源	所处阶段
先进制程工艺适配技术	1	介质输送过程微污染防控技术	聚焦于研磨液、化学品等核心介质在输送全流程中的微污染风险，围绕先进制程对粒径、金属离子及溶出物高度敏感的特性，构建了从源头到末端的全链条洁净输送体系。通过前端制造管控与供液装置结构优化，提升密封性与耐腐蚀性，降低渗漏、积液及死角沉积风险；同时搭配化学品快速过滤装置，优化过滤结构与滤材选择，在不改变介质原有特性的前提下，高效去除微颗粒及微量杂质。系统采用自动化清洗接头与防呆型快速连接结构，减少误操作引入空气与污染物的可能。研磨液系统进一步整合原液桶吸管自动清洗与排空机制，避免残留与交叉污染。整体方案实现高稳态、高洁净度的输送环境，满足先进制程对微污染“零容忍”的要求。	自主研发	量产阶段
	2	化学品精准混配与稳定供应控制技术	针对先进制程对化学品配比精度、参数稳定性及连续供给一致性的高标准要求，构建了一体化混配与稳定供给技术体系。系统依托高精度流量计量与闭环控制算法，实现酸、碱、水及功能性添加剂的比例精准调控，将浓度波动控制在微尺度范围内；同时通过优化搅拌结构与流体动力学设计，提升混配均匀性。在供给环节，系统整合温度、压力、流量及pH值的动态调节机制，并且结合气液分离结构设计，有效减少气泡干扰及物化特性波动风险，全面提升供液过程的稳定性与可靠性，确保下游关键工艺的持续稳定运行。	自主研发	量产阶段
	3	在线混酸技术	与传统桶槽批量混酸模式相比，在线混酸设备采用连续动态配比方式，对流量控制稳定性及管路结构设计提出更高技术要求，需确保系统内流体无滞留、无死角流动，以保障混配过程的稳定性与一致性。与此同时，在线混酸系统结构更为紧凑，可显著减少设备占地面积，提升空间利用效率，在厂务规划与产线布局优化方面展现出更高的灵活性与适配能力。	自主研发	量产阶段
介质特性分析与流体仿真设计技术	1	介质特性分析技术	随着泛半导体工艺持续升级，化学介质能力日益复杂。公司构建了系统化的介质特性分析体系，对腐蚀性、黏度、密度、挥发性、反应性及气液平衡等关键参数进行综合评估，并结合温度、压力与浓度变化开展动态物性分析。 依托长期积累的化学应用与高纯设备制造经验，公	自主研发	量产阶段

			司在设计阶段前置识别材料兼容性、腐蚀失效及流体稳定性等关键风险，科学指导管路选材与结构优化，实现由经验判断向数据化、工程化决策转型。		
	2	流体动力学仿真技术	针对半导体供液系统及研磨液混合输送等关键场景，公司运用计算流体动力学技术对介质输送与混合过程进行建模分析，模拟不同工况下的流动、温度、浓度与压力变化，研究运行参数对介质特性的影响规律。 基于仿真结果，公司优化结构设计与混合方式，实现输送过程的稳定控制；同时通过模型预判异常并前置修正关键参数，提升系统效率与风险识别能力，缩短新设备设计与验证周期。	自主研发	量产阶段
高效自动化控制技术	1	电子级化学品自动灌装技术	高纯化学品灌装是保障产品洁净度与品质一致性的关键环节。公司围绕高效自动化与洁净控制理念，构建涵盖清洗、充填、锁盖、输送、贴标及码垛等环节的一体化自动洁净灌装系统，实现少人化连续运行、精准计量控制与全过程可追溯管理。系统融合自动视觉识别技术，可实时识别桶槽状态并精准判断残液情况，对灌装及清洗过程进行动态优化，减少残留量、提升原料利用率，全面提升灌装作业的自动化水平、运行效率与安全稳定性。	自主研发	量产阶段
	2	化学品在线监控与分析技术	化学品纯度与参数稳定性直接影响晶圆良率及制程可靠性，微量杂质或浓度波动均可能引发产品缺陷。公司全系设备均搭载关键参数闭环调控能力，其中灌装系统配套自动补液功能，可精准管控每桶化学品充装量与浓度，从源头保障产品品质均一性与供液安全。 同时，公司各类系统均可选配自动取样、在线检测模块，实现化学品品质实时分析与即时判定，既能规避人工取样带来的操作风险与化学品暴露隐患，也大幅提升检测效率与数据精准度。	自主研发	量产阶段
	3	生产数据自动分析技术	系统基于设备元件信息及专业技术参数，构建统一的标准数据库体系，围绕设备运行状态、关键工艺参数及环境监测指标，建立覆盖数据采集、分析、存储与预警在内的全流程管理机制。当相关参数接近或超出设定阈值时，系统可自动触发提示与分级预警响应；同时，对化学品使用量、更换周期及厂务运行数据进行持续记录与归档，为运行管理、参数优化及成本控制提供量化支撑。 该数据驱动型管理体系实现了全过程数字化留痕与可追溯管理，支持运行状态回溯分析及问题根因定位，有效降低人为判断差异带来的波动风险，进一步提升设备运行的稳定性、一致性以及生产管理的透明度与可控水平。	自主研发	量产阶段
湿法工艺高效控制技术	1	单片药液高效回收与循环再生系统	采用特殊腔体结构设计与介质分层回流装置，通过风压自动调节系统精准控制药液扩散路径，实现液态与气态介质流场的有效分隔，降低交叉干扰与污染风险。系统同时配置稳定的化学药液温控机制，确保工艺参数持续稳定运行。在此基础上，优化介质循环与回收路径，使介质回收率可达 95%以上，并实现零交叉污染的过程控制目标。	自主研发	量产阶段
	2	精密喷洗控制与稳定输出技术	基于半导体对工艺处理均匀性与压力稳定性的高要求，系统采用高精度运动控制与闭环调节机制，实现喷洗过程的平稳启停与动态参数匹配，有效降低瞬时压力波动对晶圆表面的影响。通过稳压输出设计与无级工艺调节控制技术，确保喷洗压力、流量与作用时间在设定区间内连续稳定运行，提升工艺重复性与一致性。 同时，在喷嘴结构与介质输送路径方面进行耐久优	自主研发	量产阶段

			化与流场匹配设计，有效改善液体雾化分布与冲击均匀性，降低局部应力集中与偏流风险，使工艺处理均匀性稳定控制在 3%以内，适配 12 英寸及以上晶圆制程要求。通过对独立供液单元的精细化控制设计，进一步抑制残液滞留与滴漏问题，提升清洗过程的精度与稳定性。		
	3	光学检测模块集成技术	将原本分散在不同工序间的宏观与微观光学检测与识别模块整合进主设备系统，实现工艺、检测与控制的一体化架构。通过重构信号与控制链路，减少数据延迟与干扰，提升系统响应效率与整体稳定性，同时优化设备空间利用与运维流程。检测模块与故障检测系统形成闭环联动，在工艺执行过程中同步完成对位与缺陷识别，并根据分析结果即时修正工艺参数，从源头降低不良率与返工损耗。在工艺能力方面，系统具备高精度蚀刻控制与稳定的尺寸管理能力，可支撑高密度、小型化封装对一致性与可靠性的要求。	自主研发	量产阶段
绿色化学 品循环再 生技术	1	金属电解回收技术	电子制造业在电镀、蚀刻等制程中会产生大量含金属废水。传统处理方式通常通过化学沉淀生成金属污泥后外运处置，不仅增加处理成本，也难以实现资源回收利用。本技术采用电化学金属离子回收工艺，通过可控电解反应将废水中的金属离子直接还原为高纯度金属，实现由“末端处置”向“源头资源化”的转变，显著减少污泥产生与后续处理负担。 系统可根据不同废水中的金属成分与浓度特性进行模块化整合设计，并结合分离与纯化技术优化金属回收效率与纯度，提升整体运行稳定性与适应能力。该技术具备向多种金属离子资源化回收扩展的能力，在降低环保处理成本的同时，实现资源循环利用，兼具经济价值与环境效益。	自主研发	小试阶段
	2	电子级溶剂回收与纯化再利用	针对光电及半导体制程中产生的高浓度剥离液与有机废液，通过高效分离与精制技术，将废液中的有效成分提纯后重新回到生产流程，实现厂内循环使用。系统在架构上优化传统多单元配置，通过结构整合与热能回收设计，提高分离效率与回收率，同时降低能耗与设备占地。设备支持自动化启停与稳定运行，可适应不同废液条件，减少操作负担并提升运行可靠性。回收后的溶剂可根据制程需求进行在线调配，达到电子级使用标准。该技术不仅降低原料采购与废弃处理成本，也有效减少废弃物外运风险，推动绿色制造与循环经济实践。	自主研发	量产阶段
结构设计 与数据安全 防护技术	1	结构安全与可靠性工程技术	化学系统涉及高危介质的输送与处理，其运行安全性直接关系到生产连续性与系统稳定性。公司以“安全驱动设计”为核心理念，在系统架构层面将安全锁止、密封隔离（符合 SEMI 相关防爆规范）、防误操作及风险分级控制等关键机制融入整体结构设计，实现对高危介质的风险管控，从源头降低误操作与泄漏风险。同时，系统在工程设计阶段充分考虑结构载重力、设备受力分布及长期运行稳定性要求，通过强化承载结构与支撑体系设计，确保在复杂工况与长期运行条件下仍保持结构安全与性能稳定，进一步提升整体可靠性与运行能力。	自主研发	量产阶段
	2	数据安全与分级防护设计技术	围绕化学系统运行数据的完整性与保密性，建立分级权限管理与数据隔离机制，对关键工艺参数、设备运行数据及操作记录进行分层存储与访问控制，防止未授权篡改与误操作风险。系统通过日志留痕与异常操作识别机制，确保数据全过程可追溯与可	自主研发	量产阶段

			核查。同时在控制层采用工业级 PLC 架构，并配置通信链路冗余与光纤双回路设计，在断电、网络中断或突发异常情况下，系统可维持关键控制功能或安全停机状态，避免数据丢失及设备失控风险。通过强化控制单元稳定性与通讯可靠性，提升系统在复杂工业环境下的连续运行能力，保障生产数据与工艺过程的真实、完整与可控。		
--	--	--	---	--	--

截至报告期末，公司已形成多项自主可控的核心技术，通过深度整合化工工艺、流体力学、精密机械、自动控制及材料科学等领域技术，全面覆盖化学品的精准配比输送、工艺反应控制、纯化复用的生命周期，形成了坚实的技术壁垒，助力集成电路、显示面板等下游高端制造行业实现安全可控与绿色可持续发展。

2、发行人核心技术取得的专利或其他技术保护措施

公司高度重视核心技术的保护，通过与核心技术人员签署《保密及竞业限制协议》明确权责，有效防范技术泄密风险。同时，公司制定了知识产权相关管理制度，保障研发成果及时受到知识产权保护。截至 2025 年 12 月 31 日，公司核心技术取得的专利情况如下：

序号	核心技术名称	专利号/申请号	专利名称	专利类型
1	介质输送过程微污染防控技术	2024SR2093287	冠礼 CDS 设备输送管路中药液品质（微粒子）监控系统应用软件 V1.0	软件著作权
		ZL202421758764.2	液体颗粒物检测装置	实用新型
		ZL202411355751.5	一种半导体用化学品快速过滤装置	发明
		ZL202410530676.5	一种半导体用高纯化学品自动取样分析方法及系统	发明
2	化学品精准混配与稳定供应控制技术	ZL201721263351.7	一种研磨液混合供应设备	实用新型
		ZL201921536611.2	铜酸溶液混合系统	实用新型
		ZL202122546543.1	一种光刻胶混配过滤供应设备	实用新型
3	在线混酸技术	ZL202423012105.7	一种可调式定量加液容器及研磨液混合装置	实用新型
		ZL201621054965.X	研磨液混酸稀释系统	实用新型
		ZL201821790617.8	一种改进型滴定分析容器	实用新型
		ZL201821790663.8	一种多用途高负载高精滴定仪	实用新型
		ZL202021829391.5	一种风囊定容器微量可调系统	实用新型
4	介质特性分析技术	ZL202310660273.8	抗气泡高稳定性折光计	发明
		ZL201610821080.6	一种电子式 HF 升降温系统	发明

		ZL201721263152.6	一种有机溶剂清洗槽	实用新型
		ZL201621053371.7	酮酸供应温度控制系统	实用新型
5	流体动力学仿真技术	ZL202311186494.2	一种半导体供液设备及供液方法	发明
		ZL202222357775.7	一种制程槽体流场测试装置	实用新型
6	电子级化学品自动灌装技术	ZL202310441191.4	一种全自动化学品灌装设备	发明
		ZL202411024960.1	一种半导体化学品药液桶清洗装置	发明
		ZL202310338728.4	一种全自动化学品桶清洗设备	发明
		ZL202222641145.2	一种新型全自动电子级化学品灌装流水线系统	实用新型
		ZL201822011871.X	电子级化学药液槽罐车充填设备	实用新型
		2022SR1232309	冠礼无人值守全自动充填设备控制系统应用软件 V1-0	软件著作权
7	化学品在线监控与分析技术	ZL202122480752.0	一种新型在线式化学品浓度测量装置	实用新型
		ZL202122447746.5	一种可调型气泡检测装置	实用新型
		ZL201821790632.2	一种滴定仪用试样气泡检测系统	实用新型
		2025SR0120398	冠礼多秤心静态重量测量及失效自诊断系统应用软件【简称：电子秤配置软件】V1.0	软件著作权
8	生产数据自动分析技术	2025SR0808579	冠礼科技 UBM 工艺数据可视化分析软件 V1.0	软件著作权
		2024SR1281348	冠礼科技自研图表自动化系统应用软件 V1.03	软件著作权
		2024SR0364313	冠礼科技监控机台模拟量数据软件 V1.03	软件著作权
		2025SR1857332	冠礼基于数据处理的智能化报表系统应用软件 V1.0	软件著作权
		2025SR0185264	冠礼物料自动识别系统应用软件 V1.0	软件著作权
9	单片药液高效回收与循环再生系统	ZL202511293236.3	一种用于半导体制程的湿法循环管路脱泡装置及方法	发明
		ZL202411838441.9	一种用于晶圆蚀刻的药液循环系统及蚀刻设备	发明
		ZL202411757358.9	一种基于半导体加工的蚀刻设备	发明
		2025SR0842206	冠礼科技自研金属有机蚀刻机台的控制系统应用软件 V1.04	软件著作权
10	精密喷洗控制与稳定输出技术	ZL202311213207.2	一种半导体晶圆清洗机摆臂机构	发明
		ZL202420554535.2	一种光刻胶温控系统	实用新型
		ZL202122496976.0	一种交替式纯水高压喷雾清洗系统	实用新型
		2025SR0717672	冠礼科技全自动 4C 铜钛刻蚀设备控制软件 V1.00	软件著作权
		2021SR1939634	冠博交替式纯水高压喷雾清洗设备控制软件 V1-0	软件著作权
11	光学检测模块集	ZL202411678641.2	一种晶圆校正装置及控制方法	发明

	成技术	ZL202510217095.0	一种半导体晶圆的定位装置	发明
		ZL202411077126.9	一种涂胶显影机晶圆定位装置	发明
		ZL201921535869.0	一种三步夹持晶圆定位机构	实用新型
		2025SR0831243	冠礼科技基于 SECS/GEM 标准的单片清洗机控制程序和监视系统应用软件 V1.0	软件著作权
12	金属电解回收技术	ZL202310370613.3	一种废弃剥离液回收再利用设备	发明
		ZL202021821167.1	一种研磨液回收再利用系统	实用新型
13	电子级溶剂回收与纯化再利用	ZL202410750305.8	一种剥离液分离监控系统及控制方法	发明
		ZL201921535868.6	二甲基乙酰胺回收系统	实用新型
		ZL202222116728.3	一种新型 TMAH 显影液再生及浓度管理系统	实用新型
14	结构安全与可靠性工程技术	ZL201921728720.4	一体式门锁安全装置	实用新型
		ZL201921771935.4	一种改进型防呆酸桶快速连接系统	实用新型
		ZL201721263373.3	一种高精度管道防电磁波干扰装置	实用新型
		ZL201821919890.6	防呆型化学桶快速连接接头	实用新型
15	数据安全和分级防护设计技术	2024SR0778818	冠礼科技单片清洗机图表数据监测软件 V1.37	软件著作权
		2024SR0126286	冠礼科技 PA/Chiller 远程控制软件 V1.0	软件著作权
		2025SR0063218	冠礼 Develop 显影设备控制软件 V1.00	软件著作权
		2024SR1280850	冠礼 PLC 标签数据通信控制软件 V1.00	软件著作权
		2019SR1100539	冠礼湿制程设备条形码管理系统应用软件 V1-0	软件著作权

（四）研发水平

1、研发投入成果转化情况

公司自成立以来始终专注技术研发，围绕高纯工艺介质及湿法制程领域，构建了覆盖先进制程工艺适配、介质特性分析与流体仿真设计、高效自动化控制、湿法工艺高效控制、绿色化学品循环再生以及结构设计与数据安全防护在内的六大技术平台。基于上述技术平台，公司形成了多项核心技术，并已成功应用于主要产品，实现了技术成果向商业化应用的持续转化。

报告期内，公司核心技术产品收入及占主营业务收入比例情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
----	---------	---------	---------

核心技术产品收入	129,957.31	125,104.83	82,766.00
主营业务收入	131,776.76	126,921.76	83,968.39
占比	98.62%	98.57%	98.57%

报告期各期，公司核心技术产品收入占主营业务收入比例分别为 98.57%、98.57%及 98.62%，核心技术产品收入占比始终保持较高水平，公司核心技术已实现产业化。

2、获得的主要荣誉

序号	主体	名称	编号	颁发机构	有效期/颁发日期
1	冠礼科技	高新技术企业	GR202532002557	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2025 年 11 月 18 日至 2028 年 11 月 18 日
2	冠礼科技	专精特新“小巨人”企业	-	工业和信息化部	2024 年 9 月至 2027 年 9 月
3	冠礼科技	企业技术中心	-	江苏省工业和信息化厅	2025 年 12 月 26 日
4	冠礼科技	专精特新中小企业	-	江苏省工业和信息化厅	2025 年 12 月至 2028 年 12 月
5	冠礼科技	瞪羚企业	-	江苏省新质生产力促进中心	2025 年 9 月 11 日
6	冠礼科技	“三首两新”认定技术产品企业	-	江苏省工业和信息化厅	2025 年 7 月 16 日
7	冠礼科技	创新型中小企业	-	苏州市工业和信息化局	2025 年 6 月 6 日
8	冠礼科技	企业知识产权管理贯标备案单位	-	江苏省知识产权局	2024 年 5 月 31 日
9	冠礼科技	上云企业	-	江苏省工业和信息化厅	2024 年 1 月 15 日
10	冠礼科技	三星级上云企业	-	江苏省工业和信息化厅	2023 年 12 月 27 日
11	冠礼科技	民营科技企业	-	江苏省民营科技企业协会	2023 年 10 月 30 日
12	冠礼科技	首台（套）重大装备	-	苏州市工业和信息化局、无锡市工业和信息化局、常州市工业和信息化局	2025 年 11 月 25 日
13	冠礼科技	市级企业技术中心	-	苏州市人民政府	2023 年 12 月 28 日
14	冠礼科技	苏州市高阶湿制程清洗设备工程技术研究中心	-	苏州市科学技术局	2023 年 12 月 22 日
15	上海冠礼	高新技术企业	GR202431002024	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室	2024 年 12 月 4 日至 2027 年 12 月 4 日
16	上海冠礼	专精特新中小企业	-	上海市人民政府办公厅	2026 年 3 月 10 日
17	上海冠礼	创新型中小企业	-	上海市经济和信息化委员会	2023 年 3 月 17 日

（五）主要经营和财务数据及指标

项目	2025/12/31 2025 年度	2024/12/31 2024 年度	2023/12/31 2023 年度
资产总额（万元）	182,508.55	226,975.30	194,196.36
归属于母公司所有者权益（万元）	72,935.34	55,593.64	32,120.06
资产负债率（母公司）	42.11%	48.80%	53.90%
资产负债率（合并）	60.04%	75.51%	83.46%
营业收入（万元）	133,030.71	128,170.26	84,304.79
净利润（万元）	20,847.27	20,045.28	9,011.42
归属于母公司所有者的净利润（万元）	20,847.27	20,045.28	9,011.42
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	20,217.70	19,641.38	3,499.71
基本每股收益（元/股）	0.99	1.26	2.17
稀释每股收益（元/股）	0.99	1.26	2.17
加权平均净资产收益率（%）	32.44	44.65	42.98
经营活动产生的现金流量净额（万元）	6,685.62	35,934.35	3,002.32
现金分红（万元）	5,000.00	4,000.00	11,051.31
研发投入占营业收入的比例（%）	4.46	3.81	4.70

（六）发行人存在的主要风险

1、行业需求波动与技术迭代风险

公司所属行业为半导体器件专用设备制造业，主要产品广泛应用于集成电路、显示面板及电子化学品等高端制造领域。报告期各期，公司主要产品收入占主营业务收入的比例分别为 98.57%、98.57%及 98.62%，其市场需求与下游行业景气度、资本开支规模高度相关，周期性特征较为显著。

集成电路、显示面板等行业作为电子信息产业的核心支柱，其发展节奏与宏观经济环境、国际贸易格局、终端消费市场需求、技术迭代进程、产业扶持政策等多重因素深度绑定，若未来全球半导体产业景气度进入下行周期，AI 算力、消费电子、新能源汽车等下游终端市场需求不及预期，将直接导致厂商收缩资本开支计划、放缓新建产线布局与现有产能扩张节奏，进而使得市场对公司核心产品的采购需求出现大幅波动。在此情形下，公司将面临新增订单获取

不及预期、在手项目交付周期延长、营业收入与利润规模下滑的经营风险。

与此同时，下游行业技术迭代迅速，先进制程产线对配套设备的精度、稳定性、洁净度等核心指标要求持续升级。若公司未能紧跟下游行业技术迭代步伐，及时完成适配先进制程产线的技术研发与产品升级迭代，将无法持续满足下游客户的核心需求，进而面临市场份额下滑、核心竞争力弱化的不利局面，对公司持续盈利能力造成影响。

2、市场竞争加剧风险

公司所处行业是集成电路、显示面板及电子化学品生产环节的关键配套领域，公司产品性能直接决定下游产线的制程精度、运行稳定性与产品良率，具备技术壁垒高、客户认证周期长、品牌粘性强的特征。全球市场范围内，该领域早期由国际巨头主导，该类企业凭借长期技术积累、全球化的供应链布局与服务网络、丰富的产品矩阵，与主流厂商建立了深度合作关系，具备较强的市场竞争优势。而随着半导体产业国产化进程的持续加速，国内市场亦涌现出多家具备技术研发能力与规模化交付能力的同行业企业，参与者持续增加使得市场竞争日趋激烈。国内同行业企业依托本土化服务优势、成本优势与政策扶持红利，在成熟制程领域快速实现技术突破与客户认证，逐步形成了自身的细分赛道优势与客户资源壁垒；更有部分企业通过产能扩张、产业链上下游协同布局等策略，持续抢占市场份额，进一步加剧了市场的竞争格局。

目前，公司在全品类产品覆盖、先进制程领域的技术储备等方面已形成差异化的竞争优势，整体业务规模与全球化市场布局亦处于稳步拓展阶段。但若未来国际龙头企业加码中国市场本土化布局与价格竞争，国内同行业企业亦通过技术突破、服务升级持续争夺市场份额，而公司未能通过技术创新、产品迭代、成本管控巩固核心竞争力，将面临市场竞争加剧的风险，进而出现市场份额萎缩、毛利率下滑及经营业绩不及预期的影响。

3、控股股东同业竞争风险

公司直接控股股东台湾朋亿经营高科技产业制程化学品供应系统销售与整合工程服务，属于与公司的主营业务存在相同或相似业务的情况。报告期内，公司与台湾朋亿在中国台湾以外地区存在不构成重大不利影响的同业竞争的情

形。截至报告期末，双方已不存在同业竞争。除此以外，公司控股股东及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争的情况。台湾朋亿 2023 年和 2024 年竞争性业务产生的收入或毛利合计未超过公司主营业务收入或毛利的 30%，2025 年台湾朋亿不存在与公司产生竞争性业务的收入，其与公司的同业竞争未对公司经营产生重大不利影响。

若未来台湾朋亿在中国台湾以外市场的收入或毛利规模进一步扩大，且未能合理规划并修正其旗下经营主体的业务方向及细分市场领域，则可能构成对公司存在重大不利影响的同业竞争，进而对公司的业务发展构成一定的不利影响。

4、应收款项规模较大风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 20,346.46 万元、27,893.06 万元及 33,759.58 万元，占当期营业收入的比例分别为 24.13%、21.76%及 25.38%，整体呈增长趋势。公司已按照企业会计准则及会计政策要求，基于账龄组合对应收账款计提了相应的坏账准备，报告期各期末坏账准备余额分别为 2,802.63 万元、3,810.77 万元及 3,628.29 万元。

公司下游客户主要为国有企业、上市公司及行业龙头企业，资信状况整体良好，但该类客户内部付款审批流程较为复杂、结算周期相对较长，导致公司应收账款回收管理难度及工作量较大。若未来宏观经济环境发生不利变化，或部分客户因经营状况恶化、资金周转压力等因素导致支付能力下降，而公司未能及时识别风险并采取有效催收措施，则可能存在应收账款回收周期延长、坏账损失增加的风险，进而对公司现金流状况及经营业绩产生不利影响。

5、存货跌价风险

报告期内，随着公司业务规模持续增长，项目执行周期内累计投入的合同履约成本规模较大。报告期各期末，公司存货中合同履约成本账面余额分别为 93,901.11 万元、106,862.79 万元及 75,905.77 万元，占各期末流动资产的比例分别为 51.07%、50.23%及 45.04%，整体规模较大。

若未来出现半导体行业景气度下行、下游客户经营状况恶化或资金压力加剧等不利情形，可能导致部分项目执行进度放缓、合同范围调整或终止。在此

情况下，公司存货可能存在跌价风险，且部分已发生的大额项目成本可能无法通过合同款项得到全额补偿，从而对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

二、本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 7,000 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板股票交易账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		

三、保荐人项目成员情况

（一）保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为张博雄和夏建阳，其保荐业务执业情况如下：

张博雄先生：东吴证券投资银行业务委员会业务总监，保荐代表人、注册会计师、硕士研究生，11 年投资银行从业经历。曾担任圣晖集成（603163）IPO 项目保荐代表人，组织或参与赛英电子（920181）、龙腾光电（688055）、中泰证券（600918）、南京证券（601990）、高科石化（002778）的首次公开发行，迈为股份（300751）的非公开发行，高科石化（002778）重大资产重组等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

夏建阳先生：东吴证券投资银行业务委员会业务总监，保荐代表人、注册会计师、硕士研究生，18 年投资银行从业经历。曾组织或参与上海凯宝（300039）IPO、蓝丰生化（002513）IPO、南京银行（601009）2015 年非公开发行优先股、高科石化（002778）IPO、南京证券（601990）IPO、中泰证券（600918）IPO、上声电子（688533）IPO、圣晖集成（603163）IPO、中裕科技（871694）北交所 IPO、赛英电子（920181）北交所 IPO 等项目，以及多家企业的财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐

业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人及项目组其他成员

本次证券发行项目协办人为姜振兴，其保荐业务执业情况如下：

姜振兴先生：注册会计师，曾参与固德电材（301680）、福立旺（688678）首次公开发行及多家企业的财务顾问等工作。

项目组其他成员：吴含舒、薛佳梓、崔琪、陆逸峰、骆云天、赵桢宇。

（三）联系方式

联系人：张博雄、夏建阳

联系地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

电话：0512-62938168

四、保荐人与发行人之间的关联关系

（一）本保荐人及控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份（本次发行战略配售除外）；

（二）发行人或其控股股东、重要关联方除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东及重要关联方股份，不存在在发行人或其控股股东及重要关联方任职的情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、重要关联方不存在相互提供担保或者融资的情况；

（五）保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

本保荐人承诺：

保荐人已按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发

行人及其控股股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会和深圳证券交易所所有有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，并接受深圳证券交易所的自律监管；

（九）遵守中国证监会规定的其他事项。

六、发行人履行的决策程序

2026年3月12日，发行人召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》、《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于股东会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》等与本次证券发行上市相关的议案。

综上，保荐人认为，发行人已依据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及发行人公司章程的规定，就本次证券的发行履行了完备的内部决策程序。

七、关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明及核查情况

（一）公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展

公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第二、三条的规定，能够通过自身的创新、创造、创意促进新质生产力发展。

公司长期深耕集成电路、显示面板及电子化学品等泛半导体领域，围绕液态化学品全流程管理需求，布局从前端材料纯化与分装、中端精准供应与工艺实现，到末端废液资源化再生的全链条产品体系，打造出安全可控、降本增效、绿色环保的运营生态，深度契合相关产业的发展方向。公司的创新、创造、创意特征主要体现在以下方面：

1、以技术创新为引领，构建全流程业务新生态

在泛半导体产业向更高精度与绿色制造持续演进的背景下，公司始终以技术创新作为核心驱动力，持续完善研发与工程化能力。公司已组建一支超百人的多学科研发团队，专业覆盖化学工程、机械设计、自动化控制及系统工程等领域，并在苏州、上海等地设立研发中心，形成跨学科协同的技术研发体系。

公司搭建了以平台化为基石的研发体系，重点开展三个方向的研究：一是聚焦相关产业“高纯度、高稳定、低能耗”的核心需求，持续推进材料特性、工艺机理及系统设计等关键技术研究；二是依托成熟技术平台，以市场趋势为导向，针对产线兼容性、制程升级及工艺差异化需求开展技术优化与迭代；三是基于技术平台储备，探索前沿技术方向，为未来技术发展奠定基础。

通过持续的技术积累与研发投入，公司在相关技术领域取得多项突破，并形成较为完善的知识产权体系。截至报告期末，公司已获得发明专利 64 项，实用新型专利 112 项、外观设计专利 18 项，并拥有计算机软件著作权 51 项，为公司技术发展与业务拓展提供了重要支撑。

2、以产品创新为驱动，铸就全链条发展新格局

依托二十余年行业积累与对产业发展的深入理解，公司持续推动产品创新与迭代升级。围绕液态化学品全流程管理需求，构建覆盖前、中、后端的全链条产品矩阵，将业务版图扩展至集成电路、显示面板及电子化学品等多元产业领域。

电子级化学品是泛半导体制造中不可或缺的“血液”，其在生产与流通过程中需达到“超净高纯”标准，以确保其在泛半导体产业中的工艺可靠性。凭借在电子级化学品领域的技术积淀，公司于 2012 年参与了国家标准《电子工厂化学品系统工程技术规范》（GB 50781-2012）的编制，将自身经验转化为通用标准，为电子工厂化学品系统的规范化建设提供关键技术支撑。

同时，公司也积极将行业认知转化为实践应用。公司成立初期即能够为 8 英寸晶圆厂生产线提供其所需的自动化化学品供应系统，此后数年与多家国内外知名晶圆制造企业展开合作，为其实现工艺介质的稳定供应，高效赋能从成熟制程到先进制程产业链的持续发展。2011 年，公司为国内首条自主建设的最高世代 TFT-LCD 生产线交付剥离液回收再生处理系统，该套系统通过高精度纯化再生工艺，可将废弃剥离液的资源化利用率提升至 90%以上，有效减少废液、显著优化成本结构，引领面板行业的绿色制造升级；2013 年，公司为国内首个 ppt 电子级氢氟酸生产项目交付精馏纯化与分装系统，助推国内电子级氢氟酸供给能力的提升。基于对产线工艺流程、化学介质特性与污染控制的深刻洞察，公司突破产品边界，实现了向高阶湿制程工艺设备的创新延伸。至 2020 年，公司已可实现单片式机台的量产，标志着在高阶湿制程工艺设备领域的关键突破；2025 年，公司全自动单片式晶圆蚀刻设备入选苏锡常首台（套）重大装备名单，验证了公司具备攻克先进制程关键工艺所需的技术竞争力。

截至目前，公司已与国内外众多知名厂商建立长期稳定的战略合作关系，产品深度融入多条 12 英寸晶圆代工先进制程产线，展现了公司在高端制造领域的产品适配能力与客户认可度。未来，公司将持续加大研发投入，深化与产业链上下游的协同创新，为产业高质量发展提供更有力的支撑，充分发挥资本市场对科技创新的赋能作用。

综上，公司始终以创新作为核心发展动力，构建起技术、产品、业态协同联动的创新体系，在实现自身成长的过程中，通过推动相关行业的产业化突破与绿色低碳转型，有力促进了新质生产力的培育与发展。公司的业务契合创业板“创新驱动、服务成长型创新企业”的定位要求，具备“创新、创造、创意”与“新技术、新产业、新业态、新模式”的典型特征。

（二）公司所属行业符合创业板行业领域

公司主要从事高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售。根据《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》，公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中“C3562 半导体器件专用设备制造”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“1 新一代信息技术产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

公司所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业，也不属于禁止产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。公司不存在主要依赖国家限制产业开展业务的情形。

（三）公司符合创业板定位相关指标

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条规定，公司符合创业板定位相关指标二的要求，具体如下：

创业板定位相关指标二	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	√是 □否	最近三年（2023 年度至 2025 年度），公司累计研发投入为 14,791.27 万元，超过 5,000 万元。
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%，最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。	√是 □否	公司最近一年（2025 年度）营业收入为 133,030.71 万元，可不用该指标关于营业收入复合增长率要求。

（四）公司主营业务具备成长性

1、公司业务规模及盈利能力稳定提升

报告期内，主营业务收入分别为 83,968.39 万元、126,921.76 万元及

131,776.76 万元，呈稳定增长态势。扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润由 2023 年度的 3,499.71 万元增至 2025 年度的 20,217.70 万元，复合增长率为 140.35%，报告期内业务规模及盈利能力稳定提升。

2、自动化化学品与研磨液供应系统技术优势加持助力公司业绩稳定增长

作为公司营业收入的核心贡献产品，公司的自动化化学品与研磨液供应系统以输送纯净与稳定的工艺介质为核心目标，依据不同化学特性选用不同的高洁净耐腐材料，从硬件端保障核心工艺指标的精准控制。在金属控制方面，公司该产品对金属杂质控制可达到 SEMI G5 等级；在颗粒控制方面，在 28nm 以下的先进制程中可实现颗粒 $\geq 0.02\mu\text{m}$ 、 $< 10\text{-}20$ 个/mL 的控制，达到行业领先水平；在输送稳定性方面，系统搭载全自动流量监控与液气分离装置，配备带压差监测功能的安全通排风管道，全方位保障工艺安全与介质输送的稳定性连续保障生产方面，系统配备智能旁路（Bypass）功能与冗余泵组自动切换设计，可在泵组失效时自动完成无缝切换，避免断液风险，保障下游产线连续稳定运行；在维护便捷性方面，产品采用管路与核心部件的快拆式连接设计，从而便利维护。

公司凭借长期积累的研发技术实力，形成可持续的市场竞争力，主要产品广泛应用于集成电路、显示面板及电子化学品等领域，为业绩稳健增长提供坚实支撑。

3、公司具有较强的市场竞争力

公司作为国内高纯工艺介质系统领域的先行者，凭借二十余年的深厚的技术积淀，始终引领行业技术发展，精准响应客户的差异化需求，并持续推动产品创新与迭代。

凭借对下游客户核心诉求的深刻理解，公司以高纯工艺介质系统为业务核心，成功将业务拓展至集成电路、显示面板及电子化学品等多元产业链，积累了丰富的客户资源。公司着力于维系与优质客户的合作，已覆盖多个关键下游行业的国内外头部企业，包括中芯国际、华虹半导体、合肥晶合、长江存储、长鑫存储等知名国内龙头企业，以及住友化学等具备全球影响力的国际客户。凭借可靠的产品质量与技术服务，公司多次被中芯国际等重要客户评为“优质

供应商”，充分体现了客户对公司综合能力的高度认可。

根据弗若斯特沙利文统计，冠礼科技凭借全链条技术壁垒、头部晶圆厂客户的认证与深度合作以及在国产替代进程中的先发优势已跻身中国半导体液态化学品供应系统行业第一梯队，市场占有率居行业标杆地位，影响力持续提升。

4、公司所处行业的市场空间广阔

根据 SEMI 统计数据，2025 年全球半导体制造设备总销售规模达到 1,351 亿美元，同比增长 15%，创历史新高；预计 2026 年、2027 年，全球半导体设备总销售规模有望继续攀升至 1,520 亿美元和 1,660 亿美元。

晶圆厂设备领域（含晶圆加工、晶圆厂设施和掩模版设备）因 DRAM 及 HBM 投资强于预期及中国持续扩产，预计 2025 年将增长 11.0%至 1,157 亿美元，打破于 2024 年创下的 1,040 亿美元纪录；2026、2027 年预计再增 9.0%和 7.3%。后端设备领域 2025 年半导体测试设备销售额预计激增 48.1%至 112 亿美元，封装设备销售额增长 19.6%至 64 亿美元。2026、2027 年测试设备销售额预计继续增长 12.0%和 7.1%，封装设备销售额预计增长 9.2%和 6.9%。

从产品结构来看，光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备作为晶圆制造环节的核心工艺装备，合计占全球半导体设备市场比例超过 60%，系行业内技术壁垒最高、投资规模最大的细分领域。与此同时，随着制程节点的演进，对表面洁净度、缺陷控制及掺杂精度的要求呈指数级提升，湿法清洗、量测检测、离子注入、热处理等设备的重要性持续上升，其中湿法设备成为近年来增长较快的细分领域之一，2025 年全球湿法设备市场规模同比增长超过 7%。

综上所述，公司能够通过自身的创新、创造、创意促进新质生产力发展，符合创业板所属行业和相关财务指标的要求，具备良好的成长性，符合创业板定位。

（五）公司符合国家产业政策

公司主营业务为高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售。近年来，国家相关部门已陆续出台多项泛半导体产业政策和经济发展战略，公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略。

（六）保荐人的核查内容和核查过程

保荐人的核查内容和核查过程具体如下：

- 1、与发行人相关人员沟通，深入研究、分析发行人的经营状况、业务模式、行业地位；
- 2、查阅并分析发行人的财务数据、专利、核心技术、相关资质等资料；
- 3、查询行业相关资料，结合发行人的产品参与情况进行分析。

保荐人认为，发行人符合创业板定位及国家产业政策。

八、保荐人对发行人是否符合上市条件的说明

本保荐人对发行人是否符合《公司法》《证券法》《上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查。经核查，本保荐人认为发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

（一）发行人符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件

1、发行人符合《证券法》规定的发行条件

（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构

发行人《公司章程》合法有效，股东会、董事会、审计委员会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；发行人具有生产经营所需的职能部门且运行良好。符合《证券法》第十二条第一款第一项的规定。

（2）发行人具有持续经营能力

发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本上市保荐书签署日，发行人的生产经营符合国家产业政策，发行人不存在因违法经营而被相关行政管理部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及公司章程规定需要终止的情形。根据会计师出具的发行人报告期的审计报告等财务资料，发行人主营业务报告期的经营情况等业务资料，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第二项的规定。

（3）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

会计师针对发行人最近三年的财务报告出具了标准无保留审计意见的《审

计报告》，符合《证券法》第十二条第一款第三项的规定。

(4) 发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

根据保荐人的审慎核查以及相关政府部门出具的证明，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第四项的规定。

(5) 符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

本保荐人认为，发行人符合《证券法》规定的关于首次公开发行新股的发行条件。

2、发行人符合《注册办法》规定的发行条件

(1) 发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第三条的规定

发行人申请首次公开发行股票符合《首次公开发行股票注册管理办法》第三条的规定，详见本上市保荐书“七、关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明及核查情况”。

(2) 发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十条的规定

保荐人查验了发行人工商档案，发行人改制设立有关内部决策、审计、评估及验资文件，并核查了发行人现行有效的公司章程及报告期内的财务报表及审计报告。发行人前身冠礼有限成立于 2016 年 5 月，于 2025 年 10 月以股改基准日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。保荐人认为，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。

发行人已经依法建立健全股东会、董事会、审计委员会以及独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等制度，相关机构和人员能够依法履行职责。保荐人认为，发行人已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十条的规定。

(3) 发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十一条的规定

经核查发行人的会计记录、记账凭证等资料，结合会计师出具的《审计报告》，保荐人认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

经核查发行人的内部控制制度、内部控制执行记录，结合会计师出具的《内部控制审计报告》，保荐人认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了标准无保留结论的内部控制审计报告。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十一条的规定。

（4）发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十二条的规定

经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标等资料，并结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，以及对发行人董事和高级管理人员的访谈等资料，保荐人认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，本次发行符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。

经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售合同及主要客户、发行人工商档案及股东名册、聘任董事、高级管理人员的股东会决议和董事会决议、核心技术人员的劳动合同以及访谈文件、发行人控股股东出具的声明和承诺，结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，公司的股份权属清晰，发行人无实际控制人，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，本次发行符合《注册办法》第十二条第（二）项的规定。

经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件、企业信用报告、发行人涉及的诉讼仲裁、行业研究、分析报告等资料，结合与发行人管理层的访谈、会计师出具的《审计报告》和发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠

纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，本次发行符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十二条的规定。

（5）发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十三条的规定

经核查发行人实际经营情况及开展相关业务所涉及的准入许可及相关资质情况，查阅了与发行人所从事行业相关的国家产业政策，发行人及其控股股东、董事、高级管理人员出具的调查表，董事、高级管理人员提供的无犯罪证明、个人征信报告，取得发行人住所地相关主管政府单位出具的证明文件，查询中国证监会、证券交易所等监管机构网站及其他公开信息，并结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十三条的规定。

发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

（二）发行后的股本总额不低于 3,000 万元

经核查，发行人本次发行前股本总额为 21,000 万元，本次拟公开发行股份不超过 7,000 万股。

发行后发行人股本总额预计不低于人民币 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上

本次发行前发行人总股本为 21,000 万股，本次拟公开发行股份不超过 7,000 万股，占发行后总股本比例不低于 25%，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

（四）发行人市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准

发行人本次发行上市申请适用《上市规则》第二章 2.1.2 中规定的第（一）条：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元。

根据会计师出具的《审计报告》（XYZH/2026SUAA1B0140），发行人 2024 年度和 2025 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 19,641.38 万元和 20,217.70 万元，累计达到 39,859.08 万元。发行人最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元，符合上述上市标准。

（五）发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件

经核查，发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

九、对发行人持续督导期间的工作安排

事项	安排
（一）持续督导事项	保荐人将根据与发行人签订的保荐协议，在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，认识到占用发行人资源的严重后果，完善各项管理制度和发行人决策机制。
2、督导发行人有效执行并完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	协助发行人制定有关制度并有效实施，建立对相关人员的监管措施、完善激励与约束机制。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	尽量减少关联交易，关联交易达到一定数额需经独立董事发表意见并经董事会（或股东会）批准。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	建立发行人重大信息及时沟通渠道、督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露要求和规定。
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	定期跟踪了解募集资金项目的进展情况，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见，关注对募集资金专用账户的管理。

6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐人进行事前沟通。
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责；严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠道。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	会计师事务所、律师事务所持续对发行人进行关注，并进行相关业务的持续培训。
（四）其他安排	无

十、保荐人对本次发行上市的推荐结论

东吴证券作为冠礼科技本次证券发行上市的保荐人，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，根据法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行了充分的尽职调查。经过审慎核查，保荐人认为：冠礼科技申请其股票上市符合《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，其股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，同意推荐冠礼科技的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州冠礼科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

项目协办人： 姜振兴
姜振兴

保荐代表人： 张博雄 夏建阳
张博雄 夏建阳

内核负责人： 杨伟
杨伟

保荐业务负责人： 方苏
方苏

保荐人法定代表人、董事长： 范力
范力

